

# Technisches Datenblatt

## Vakuum-Metallisierung

EMV-Abschirmung

Cu/NiCr-Bedampfung



<b><u>Verfahren:</u></b>	Vakuum-Metallisierung nach dem PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition).
<b><u>EU-Richtlinien:</u></b>	RoHS-Konform WEEE-Konform REACH-Konform.
<b><u>Einsatzmaterial:</u></b>	Cu/NiCr - Kupfer Cu 1,5 µm - 3 µm - Nickel-Chrom NiCr 0,15µm Dreiwertiges Chrom Cr (III)
<b><u>Einsatzmöglichkeit:</u></b>	Auf fast allen Kunststoffen, Metallen und Glas. (weitere Materialien auf Anfrage).
<b><u>Schichtdicke:</u></b>	1,5 µm bis 3,0 µm
<b><u>Dämpfung:</u></b>	60 dB – 80 dB (z.B. bei Kunststoffen von 30 MHz bis 1 GHz)
<b><u>Dichte:</u></b>	8,92 g / cm <sup>3</sup>
<b><u>Elektr. Leitfähigkeit:</u></b>	59,1 x 10 <sup>6</sup> S / m
<b><u>Schmelzpunkt:</u></b>	1084 ° C
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	( λ ) : 400 W / mK